

## 奇景光電推出高於現有近紅外光靈敏度達兩倍的HM5530 UltraSenseIR™ 主要用於機器視覺與主動感應相機的5.5百萬畫素背照式影像感測器

【台南，2016年12月27日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）的子公司恆景科技今天宣布，推出 HM5530 UltraSenseIR™ 產品、一款低功耗和低噪聲的 5.5 百萬畫素背照式感光技術（BSI）CMOS 影像感測器，在近紅外光（NIR）光譜中具有超過 40% 的量子效率，能實現下一代的嵌入式計算機視覺應用，如 3D 深度相機、自主導航、事件與模式識別和人機互動。

恆景科技技術長 Amit Mitra 表示，為了不干擾人類的感知，機器視覺主要使用近紅外光和其感測器。目前視覺成像應用的主流技術是基於矽晶片的影像感測器，在成本、功耗和可擴展性都有競爭優勢，然而矽晶片的影像感測器對近紅外光譜不敏感，需要通過使用相對大的畫素尺寸來來補償，這樣也限制了為了適應嵌入式設備體積的感測器解析度。恆景利用突破性的 UltraSenseIR™ 技術，將高集成度，低功耗和低噪聲背照式感測器技術的優勢，與近紅外光和可見光高靈敏度結合在一個非常小的 2.0 微米畫素尺寸，以實現高解析度的機器視覺和近紅外光影像應用。

HM5530 以業界標準 MIPI CSI2 介面作每秒 30 張全幅輸出時，功耗小於 140mW。感測器也可透過使用標準雙線串行接口，支援與外部 LED 或雷射光源的同步訊號。隨著工程樣品準備好，恆景正在與平台廠提供商合作，為機器視覺提供整體解決方案。

### 新聞小辭典

#### BSI 背照式感光技術

將晶圓研磨至極薄而可透光，使影像感測器的畫素轉由背面感光，改善傳統前照式感光感測器畫素被線路遮擋的問題，以提高影像感測器的感光度。

#### 關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括 CMOS 影像感測 IC 及晶圓級鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約 2,100 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 2016 年 9 月 30 日為止，奇景光電在全球已取得 2,911 項專利，尚有 458 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

#### 關於恆景科技（奇景光電子公司）：

恆景科技股份有限公司是一家無晶圓廠半導體公司，致力於開發 CMOS 影像感測器（CIS），系統級晶片（SOC）和特殊應用的感測器解決方案。作為 CIS 行業的新公司，除了推出在筆記型電腦、平板電腦與手機的產品之外，恆景更專注在下一代應用於機器視覺的創新 3D 深度相機，超低耗電的全時感測器，以及在汽車上的新應用。有關詳細訊息，請參下面網址：

<http://himaximaging.com/>

#### 聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang  
公共關係 專案經理  
奇景光電股份有限公司  
Himax Technologies, Inc.  
+886-3-516-3276 分機 38817  
jessica\_huang@himax.com.tw

林佳慧 / Penny Lin  
投資人關係 經理  
奇景光電股份有限公司  
Himax Technologies, Inc.  
+886-2-2370-3999 分機 22320  
penny\_lin@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative  
Greg Falesnik, Managing Director  
MZ North America  
Tel: +1-212-301-7130  
Email: greg.falesnik@mzgroup.us  
www.mzgroup.us

**風險說明：**

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2015 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。